This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- * FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

DIALOG(R)File 352:Derwent WPI (c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

013296199 WPI Acc No: 2000-468134/200041 Silica type amorphous material for pigment, filler, lapping powder, cosmetic base, support for agriculture, adsorbent and film material in industries, has specified surface area, pore volume and pore distribution Patent Assignee: ASHI KASEI KOGYO KK (ASAH) Number of Countries:001 Number of Patents: 001 Patent Family: Patent No Kind JP 2000154017 A Applicat No Date Kind Date 19981112 200041 B 20000606 JP 98322446

Priority Applications (No Type Date): JP 98322446 A 19981112 Patent Details: Patent No Kind Lan Pg Main IPC JP 2000154017 A 9 C01B-033/146 Main IPC Filing Notes JP 2000154017 A

Abstract (Basic): JP 2000154017 A
NOVELTY - Silica type amorphous material has surface area 60-400 NOVELTY - Silica type amorphous material has surface area 60-400 m2/g, pore volume 0.1-0.4 cc/g and pore distribution (nitrogen desorption spectrum) 30-80% with pore diameter 50 angstrom.

DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is also included for the manufacture of silica type amorphous material involves preparing and drying a slurry containing silica and an oxide of sodium, potassium, calcium, zirconium, titanium, gallium, germanium or aluminum and baking the dried slurry at 800degreesC. Subsequently a hydrothermal process is carried out at 60degreesC or more.

USE - For pigment, filler, lapping powder, cosmetic base, support for agriculture, adsorbent and film material in industries.

ADVANTAGE - The silica type amorphous material has excellent mechanical strength and has uniform pore distribution.

pp; 9 DwgNo 0/1

pp; 9 DwgNo 0/1
Derwent Class: CO7; D21; E36; G01; J01; J04; S03
International Patent Class (Main): C01B-033/146
International Patent Class (Additional): G01N-030/48

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-154017 (P2000-154017A)

(43)公開日 平成12年6月6日(2000.6.6)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

C01B 33/146 G01N 30/48 C 0 1 B 33/146

4G072

G01N 30/48

K

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 9 頁)

(21)出願番号

特願平10-322446

(71)出顧人 000000033

旭化成工業株式会社

(22)出顧日 平成10年11月12日(1998.11.12)

大阪府大阪市北区堂島浜1丁目2番6号

(72)発明者 山口 辰男

静岡県富士市鮫島2番地の1 旭化成工業

株式会社内

(72)発明者 大橋 寿彦

静岡県富士市鮫島2番地の1 旭化成工業

株式会社内

(72)発明者 岡本 裕重

岡山県倉敷市潮通3丁目13番1 旭化成工

業株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 均一細孔分布を有するシリカ系非晶質材料

(57)【要約】

【課題】 機械的強度が大きく、かつ比表面積も大きなシリカ系非晶質材料を提供すること及びその再現性の良い製造方法を提供すること。

【解決手段】 a) 比表面積が60~400 (m²/g)、b) 細孔容積が0.1~0.4 (cc/g)、c) 細孔分布が窒素法脱離スペクトルから求めた細孔分布において細孔の80%以上が細孔径30~50Åの範囲に存在するシリカ系非晶質材料。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記a)~c)を満足することを特徴とするシリカ系非晶質材料。

a) 比表面積 ; 60~400 (m²/g)

b) 細孔容積 ; 0.1~0.4 (cc/g)

c) 細孔分布 ; 窒素法脱離スペクトルから求めた細孔分布において細孔の80%以上が細孔径30~50Åの範囲に存在する。

【請求項2】 シリカ系非晶質材料が、シリカとNa、K、Ca、Mgから選ばれる少なくとも1種の成分の酸化物 $0\sim15$ wt%及びZr、Ti、Ge、Ga、Alから選ばれる少なくとも1種の成分の酸化物 $0\sim15$ wt%とからなることを特徴とする請求項1記載のシリカ系非晶質材料。

【請求項3】 シリカ系非晶質材料が、アルミニウムを酸化物として $1\sim15wt\%$ 及びマグネシウムを酸化物として $1\sim15wt\%$ 含むことを特徴とする請求項2記載のシリカ系非晶質材料。

【請求項4】 シリカ単独又はシリカとNa、K、Ca、Zr、Ti、Ge、Ga、Alから選ばれる少なくとも1種の成分の酸化物からなるスラリーを調合後乾燥し、800℃以下の温度で焼成した後、さらに60℃以上の温度で水熱処理することを特徴とする請求項1、2又は3記載のシリカ系非晶質材料の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、細孔分布がシャー プに制御された、強度の大きなシリカ系非晶質材料及び その製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年細孔構造が制御された材料として結晶ゼオライトが関心を集めている。MCM-41と呼ばれるあたらしいゼオライトで、C. T. Kresgeらによって界面活性剤を用い合成され、Nature 359,710(1992)に発表されている。しかしながら、テンプレートを取り除くとかさ高で脆く機械的強度に問題があると考えられ、以後多くの研究者が強度改良等に取り組んでいる。一方、非晶質材料としては、細孔径を制御し新規なシリカゲルをつくることによって、有機分子の吸着材、あるいはクロマト用分離材などに有用な材料として関心が高まっている。

【0003】特開平6-64915号公報には、界面活性剤を含む非極性有機ハロゲン化物溶媒中で、アルカリ金属ケイ酸塩水溶液を乳化させ、次いでゲル化剤によりゲル化させて、球状シリカを製造する方法が提案されている。ここで得られる球状シリカは120℃で数時間乾燥し、ゲル間水を除去したものでゲル間水由来の細孔容積が大きく、比表面積が大きいものが得られるが、かさ高で機械的強度は小さい。特開平7-138013号公報には比表面積が700~1100㎡/g、細孔容積

が0.5~2.5ml/g、細孔径の90%が20~5 0Åのシリカゲルが報告されている。該シリカゲルも細 孔容積および比表面積が大きく、かさ高で機械的強度は 小さい。

【0004】特開平8-119621号公報には、比表面積が $50m^2$ /g以下、細孔容積が0.3m1/g以下、耐摩耗性3.0wt%/15hr以下かつ嵩密度が0.6~1.3g/m1で平均粒子径が $30~150\mu$ mであるシリカーリンーホウ素からなるシリカ系組成物の製造法が提案されている。しかし、提案されているものは触媒担体、流動調製剤などに使用するには比表面積が小さい。

【0005】ところで、シリカ系非晶質材料は様々な用途にその特性を活かした材料として利用されている。その一例を示すと液体クロマトグラフィー用充填剤、化粧品基剤、触媒担体、希釈剤等が挙げられる。これらの用途に要求される要件である高比表面積を満たそうとすると、細孔容積が大きくすることが必要であり機械的強度が小さくなる。また、機械的強度を満たそうとすると高い温度で焼成することが必要であり、比表面積が小さくなる。以上のことから機械的強度が大きく、かつ比表面積も大きいという相反する物性を満たすシリカ系非晶質材料が望まれていた。さらに、このシリカ系非晶質材料を大量に再現性よく製造する方法も望まれていた。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、機械的強度 が大きく、かつ比表面積も大きなシリカ系非晶質材料を 提供すること及びその再現性の良い製造方法を提供する ことを目的とする。

0 [0007]

40

50

【課題を解決するための手段】本発明者らは、機械的強度と比表面積の大きなシリカ系非晶質材料を得る為に鋭意研究を行ってきた。その結果、シリカを含むスラリーを成形して焼成した後に、さらに水熱処理を行うと、驚くべきことに大部分の細孔の細孔径が30~50Åの範囲に存在するような均一な細孔構造となるとともに、表面積も機械的強度も大きなシリカ系非晶質材料が得られることを見出し、本発明に至った。

【0008】すなわち、本発明は、(1) 下記a)~c)を満足することを特徴とするシリカ系非晶質材料。

- a) 比表面積 ; 60~400 (m²/g)
- b) 細孔容積 ; 0.1~0.4 (cc/g)
- c) 細孔分布 ; 窒素法脱離スペクトルから求めた細孔分布において細孔の80%以上が細孔径30~50Åの範囲に存在する、(2) シリカ系非晶質材料が、シリカとNa、K、Ca、Mgから選ばれる少なくとも1種の成分の酸化物0~15wt%及びZr、Ti、Ge、Ga、Alから選ばれる少なくとも1種の成分の酸化物0~15wt%とからなることを特徴とする(1)記載のシリカ系非晶質材料、(3) シリカ系非晶質材

料が、アルミニウムを酸化物として $1\sim15wt\%$ 及びマグネシウムを酸化物として $1\sim15wt\%$ 含むことを特徴とする(2)記載のシリカ系非晶質材料、(4)シリカ単独又はシリカとNa、K、Ca、Zr、Ti、Ge、Ga、Alから選ばれる少なくとも1種の成分の酸化物からなるスラリーを調合後乾燥し、800 $^{\circ}$ 以下の温度で焼成した後、さらに60 $^{\circ}$ 以上の温度で水熱処理することを特徴とする(1)、(2)又は(3)記載のシリカ系非晶質材料の製造方法、である。

【0009】以下に本発明を詳細に説明する。本発明のシリカ系非晶質材料は、比表面積が $60\sim400$ (m^2 /g)であり、好ましくは $60\sim300$ (m^2 /g)である。細孔容積は $0.1\sim0.4$ (cc/g)であり、好ましくは $0.1\sim0.3$ (cc/g)である。また、細孔分布は、窒素法脱離スペクトルから求めた細孔分布において、細孔の80%以上が細孔径 $30\sim50$ Åの範囲に存在することであり、好ましくは $35\sim45$ Åの範囲である。

【0010】本発明のシリカ系非晶質材料は、該材料の製造に際し、シリカ以外に含まれる成分の影響を受けにくく、シリカ以外の様々な元素を含むことが可能である。従って所望する材料の特性に合わせた組成にすることが可能である。耐水性を向上させようとする場合には、Ti、Zr, Al等を含有する組成にすれば、耐水性の向上した細孔分布の狭いシリカ系非晶質材料が得られる。さらに、中性もしくは塩基性とする場合には、Ti、Zr, Al等に加え、Na、K、Ca、Mgを含んだ組成にすることで、中性もしくは塩基性の細孔分布の狭いシリカ系非晶質材料を得ることも可能である。もちろん、シリカ単独でも細孔分布の狭いシリカゲルが得られる。

【0011】本発明において用いられるシリカ原料としては、シリカゾル、水ガラスが挙げられる。シリカゾル中のシリカコロイド粒子の平均粒子径は、通常70~500Åの範囲のものが用いられる。製造に際し粒径の異なる数種のシリカコロイドを用いることは好ましい実施態様である。Ti、Zr、Ge、Ga、Al原料としては、硝酸塩、塩化物、硫酸塩、酢酸塩、蓚酸塩等の水溶性化合物が好ましいが、シリカゾル中の未架橋シリカと反応する化合物であれば、上記水溶性化合物でなくとも用いることが可能である。添加量は例えば耐水性付与、酸性付与等目的によって異なるが、通常酸化物として1~15wt%好ましく、より好ましくは3~10wt%の範囲である。該添加量であれば細孔分布に影響なく実施することができる。

【0012】Na、K、Ca、Mg原料としては、酸化物、水酸化物、酢酸塩、硝酸塩、塩化物、硫酸塩を用いることができる。該添加量は酸性、中性、塩基性と目的によって選ばれるが通常酸化物として1~15 wt%が好ましく、より好ましくは3~10 wt%の範囲から選 50

ばれる。以下に、本発明のシリカ系非晶質材料の製造方 法を述べる。

【0013】本発明は、上記組成のシリカ含有スラリーを調合し、成形、乾燥、焼成した後にさらに水熱処理を行うことが重要である。本発明のシリカ含有スラリー調合の溶剤は通常水が用いられ、固形成分と溶剤の割合が1/100~1/2、好ましくは1/10~1/3の範囲で調合される。該調合は室温以下の0℃~50℃の範囲で行うことが好ましい。シリカ以外の成分を含む場合10は、0℃~室温の温度範囲で行うことが粘度等の大幅な変化が起こりにくく好ましい。

【0014】本発明において乾燥温度とは、スラリーか ら乾燥固体を得るための温度であり、圧力等によって最 適な温度を選ぶことができる。通常、常圧では100~ 150℃で行う。例えば噴霧乾燥で粒子を乾燥する場合 には、130~250℃の加熱空気を送風し固体の温度 が110℃となるように風量を設定して行われる。本発 明において、水熱処理前の焼成温度は220~800℃ の範囲から選ばれる。800℃を越える温度で焼成する と水熱処理効果が低下するので好ましくなく、220℃ 未満では、ゲル間の脱水や縮合反応が不十分となり細孔 容積が大きく嵩高くなり易く好ましくない。300~6 00℃の範囲が操作性等から好ましい。ただし原料とし て硝酸塩を含む場合は硝酸塩の分解温度以上で行われ る。焼成雰囲気は特に限定されないが、空気中あるいは **窒素中で焼成するのが一般的である。また、焼成時間** は、通常1~48時間、好ましくは1~12時間の範囲 で行うことができる。

【0015】本発明においては、焼成後に水熱処理する30 ことが必要である。本発明において水熱処理するとは、水又は水を含む溶液中に、上述の焼成後のシリカ含有材料(以下、シリカ系非晶質材料前駆体という。)を浸績し、一定の時間保持する操作である。シリカ系非晶質材料前駆体の細孔内に十分な水が存在し、水が物質移動の媒体となって細孔の再構成が進行すると推定している。従って温度が高いほど処理速度が高い傾向が見られ、通常、50~180℃の範囲で、1~48時間の範囲で実施される。50℃未満の低い温度でも実施は可能であるが処理時間が長くなり好ましくない。操作性、処理時間40 等から60~90℃の範囲で実施することが好ましい。

【0016】本発明において、水熱処理をすることで如何なる理由で細孔分布が狭くなるのか詳細な検討は不十分であるが、本発明者らはこの理由を次の様に推測した。シリカ含有スラリーを成形、乾燥、焼成することによって、シリカ含有スラリー中の粒子間の架橋反応が進行し、約100Å以下の細孔径を有する構造体が形成される。乾燥工程や焼成工程においては、ガス雰囲気中における加熱によるゲル間の脱水、架橋であり、固相反応であるから、得られたシリカ系非晶質材料前駆体は均一な細孔分布にはならない。ところが、さらに水熱処理を

施すことによって、シリカゲルの加水分解と再架橋反応 による反応が進行し、構造の組み替えが起こると推測さ れる。また、得られる細孔容積が粒子の最密充填による 空隙率に近いことから、水熱反応によって熱力学的に安 定な充填構造に変化し、この結果、細孔径30~50Å の狭い範囲に細孔分布を有するものが得られたものと推 測した。

【0017】なお、水熱処理前後で含まれる金属組成が 変化していないことを確認した。金属組成の分析は蛍光 X線分析(Phillips社製、PW2400)、又 はアルカリ溶融塩で溶解させ、プラズマ発光分光分析器 (Thermo Jarrel Ash社製 IRIS AP) によって測定し、各元素を酸化物換算して求め ることができる。

【0018】本発明のシリカ系非晶質材料は様々な形態 で得ることが可能である。例えば、多孔質支持体にシリ カ含有スラリーを塗布し、乾燥、焼成、水熱処理するこ とで、細孔径30~50Åの範囲の細孔が80%以上で ある、細孔分布の狭い膜材料を得ることができる。ま た、球状の粒子を得ることもできる。球状の粒子の製造 方法の一例を示すと、シリカ含有スラリーをスプレード ライヤー等で噴霧乾燥する。ついで焼成してシリカ系非 晶質材料前駆体からなる球状の粒子を得た後、さらに水 熱処理を行い細孔径30~50Åの範囲の細孔が80% 以上である、細孔分布の狭いシリカ系非晶質材料からな る球状粒子を得る。本発明のシリカ系非晶質材料の比表 面積は、窒素吸着法による測定で60~400m²/g であり、好ましく60~300m² /gである。また、 該比表面積は、水熱処理後の焼成温度を調整すること で、各用途によって要求される比表面積になるようにす ることも可能である。

【0019】本発明のシリカ系非晶質材料は、顔料、充 填剤、研磨剤、化粧品基剤、農薬用担体、触媒担体、吸 着材、膜構成材料等に好適に用いることができる。以下 に具体例を挙げて説明すると、顔料の求められる用件と しては、水、油、有機溶剤などに不溶性の微細な粉末 で、機械的強度が強いことが求められている。本発明の シリカ系非晶質材料からなる球状粒子は機械的強度が大 きく、さらに耐水性、耐油性、耐有機溶剤性にも優れて いることから、好ましく用いることができる。また、顔 料としては小さな粒子が一般的に用いられ、粒子径が1 0μm以下であることが好ましく、さらに好ましくは5 μm以下である。

【0020】本発明のシリカ系非晶質材料は、細孔径3 0~50Åの範囲の細孔が80%以上であり、細孔分布 が狭いことからインクジェットプリンター用紙のインク 吸収材などとしても有効に用いられる。また、本発明の シリカ系非晶質材料は、細孔容積が小さく、嵩密度が高 いことから、従来の合成シリカ充填剤の有していた欠点 がなく、また、機械的強度も大きいことからポリマーの 50 エステル化反応、アセチレン類のオレフィン類への部分

強度を増加させる補強剤として有用である。さらに、本 発明のシリカ系非晶質材料は、艶消し剤や塩化ビニルペ ースト、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂のプレポリマ 一粘度調整材としても有用である。

【0021】本発明のシリカ系非晶質材料からなる粒子 は、細孔径の分布範囲が狭く、様々な金属イオンをイオ ン交換によって担時することも可能である。本発明のシ リカ系非晶質材料は、前述のように製造に際し、シリカ 以外に含まれる成分の影響を受けにくく、シリカ以外の 様々な元素を含むことが可能であることから、含有させ る金属を選択することで酸触媒、塩基触媒、また触媒担 体として用いることが可能である。Tiを含有したシリ カ系非晶質材料は、チタンを含むシリカ含有スラーから 直接合成することができ、均一にチタンを含み、光触媒 として利用できる。また、Zr含有シリカ系非晶質材料 は、耐酸性に優れた担体として用いることができ、さら に耐摩耗性が要求される流動床用触媒担体として用いる 場合は、これに触媒活性成分を担持させるが、これらの 成分としては対象になる反応により活性成分が適宜選定 すれば良い。例えばモリブデン、バナジウム、コバル ト、ニッケル、銀、銅、タングステン、アルカリ金属、 アルカリ土類金属、及び又は亜鉛などの成分が挙げられ る。これらの成分を本発明の球状シリカ系非晶質材料に 担持させる方法としては、その成分に応じて通常の含浸 法、沈殿法、イオン交換法、熔融含浸法又は蒸着法など が採用される。

【0022】さらに、本発明のシリカ系非晶質材料の触 媒担体としての適用可能な反応例を挙げると、例えば酸 化エチレンからアセトアルデヒドへの異性化反応、エチ レンシアンヒドリンの脱水によるアクリロントリルの製 造反応、ホルムアルデヒドとアセトアルデヒドよりアク ロレインを合成する反応、オレフィンの水和反応、ナフ タレン又はo-キシレンの酸化により無水フタル酸を得 る反応などが挙げられる。

【0023】特にアルミニウムを酸化物として1~15 wt%、好ましくは5~15wt%、かつマグネシウム を酸化物として1~15wt%、好ましくは3~15w t%含むシリカ系非晶質材料は、パラジウム金属担持触 媒、パラジウム金属化合物担持触媒の担体として有用で ある。パラジウム金属、又はパラジウム金属化合物の担 持量は担体重量に対し、通常0.1~10wt%、好ま しくは0.1~5wt%である。

【0024】本発明の球状シリカ系非晶質材料を担体と して用いてパラジウム金属、パラジウム金属化合物を担 持させる際には、含浸法、沈殿法、イオン交換法等から 各反応にあった調製法を採用すれば良い。このようにし て調製されたパラジウム金属担持触媒、パラジウ金属化 合物担持触媒は広い触媒反応に利用することが出来る。 例えば、アルデヒドとアルコールから酸化的カルボン酸

水素化反応、パラフィン類への完全水素化反応、ジオレ フィン類のモノオレフィン化反応、オレフィンの選択水 素化反応、脂肪族脱ハロゲン化反応、芳香族脱ハロゲン 化反応、酸クロライドの還元反応、芳香族ニトロ化合物 のアミンへの水素化反応、芳香族カルボニルの水素化反 応、安息香酸の環水素化反応、フェノールのシクロヘキ サンへの水素化、芳香族ケトンのアルコールへの水素 化、芳香族ケトンのアルキル芳香族への水素化、芳香族 カルボニルの水素化分解、芳香族カルボニルの脱カルボ ニル、芳香族ニトリルアルデヒドへの水素化、シクロへ キセンの不均化、オレフィンの移動、アニリン類の還元 N-メチル化、芳香族ニトロ化合物のヒドラゾベンゼン 化合物への水素化、ニトロヘキサン類のシクロオキサノ ン類への水素化、ニトロオレフィン類のアルキルアミン 類への水素化、オキサム類の第一アミンへの水素化、脱 ベンジル反応、エポキサイドのアルコール類への水素 化、還元アミノ化、キノン類のハイドロキノン類への水 素化、芳香族エステル類の環水素化、フラン環の水素 化、ピリジン化合物の環の水素化、硝酸塩のヒドロキシ アミンへの水素化、過酸化物の水素化、脂肪族ニトロ化 20 合物の水素化、アセトオキシレーション、カルボニレー ション、脱水素反応、液相酸化反応、デオキソ反応、一 酸化炭素の酸化、NOXの還元などの触媒として利用で きる。

[0025]

【発明実施の形態】・含有量:アルカリ溶融塩で溶解さ せ、プラズマ発光分光分析器(ThermoJarre I Ash社製IRIS AP) によって測定し、各元 素を酸化物換算して求めた。

- ・比表面積:窒素ガス吸着法(島津製作所製 ソープト グラフADS-1B)で測定した。
- ・細孔容積と細孔分布:20~150 Å範囲で、窒素ガ ス吸着法(カルロ・エルバ社製 ソープトマチック18 00)で測定し、窒素の脱離スペクトルで評価した。1 50 Å以上は水銀圧入法(島津製作所製 オートポア9 200) で測定した。
- ・結晶性:理学製RINT2500のX線回折装置を用 い粉末法で測定判断した。

[0026]

【実施例1】500リットルのステンレス製容器に、硝 酸アルミニウム九水和物37.6kg、硝酸マグネシウ ム六水和物25.5kg、60%硝酸5.4kg、水4 6. 7 k g を入れ撹拌しておく。ついで、シリカゾル溶 液(日産化学(株)製 スノーテックスN-30(Si O, 30%)) 200.0kgを少しずつ加え混合さ せ、スラリーを15℃に保ち2時間撹拌する。その後、 スラリー温度を50℃になるように撹拌下に加温し、ス ラリー温度が50℃になったらそのまま24時間保持し た。このスラリーを、130℃の温度に設定したスプレ ードライヤーで噴霧乾燥し固形物を得た。つぎに、得た 50 た。水銀法からは100から10000人の範囲に細孔

固形物をロータリーキルンで室温から300℃まで2時 間かけ昇温後1時間保持した。さらに600℃まで2時 間で昇温後1時間保持した後徐冷して、球状シリカーア ルミナーマグネシア粒子Aを得た。この粒子Aを1k g、90℃に加熱された5リットルの蒸留水が入った1 0 リットルのステンレス製容器に投入し、かき混ぜなが ら24時間保持して水熱処理を行った。該処理後水分を 徳別し空気中110℃で24時間乾燥した。試料として 一部を取り80℃の真空乾燥器で24時間乾燥後、組成 分析、比表面積、細孔分布、細孔容積の測定を行った。 酸化物としてシリカ/アルミナ/マグネシア=86.9 /7.5/5.6であった。X線回折からは図1に示す ように、シリカゲルと同様の非晶質パターンが得られ た。水銀法細孔分布測定からは100から10000Å の範囲に細孔はなかった。窒素吸着法で求めた比表面積 は226 m²/g、細孔容積は0.26 m l/gであっ た。細孔分布は、表1に示したように、細孔径40~4 0Åに90%以上が存在する極めて均一な孔径分布を示 した。

[0027]

【比較例1】実施例1の水熱処理を行わなかった以外同 様の操作で得た焼成後の粒子の物性を測定した。X線回 折から、シリカゲルと同様の非晶質パターンが得られ た。水銀法からは100から10000人の範囲に細孔 はなかった。窒素吸着法で求めた比表面積141 m²/ g、細孔容積0.28ml/g、細孔分布は、表1に示 したように、細孔径分布は30~50Åに約14%しか なく、70Å近傍に幅の広いピークが存在している。

[0028]

【実施例2】原料としてシリカゾルを日産化学社製スノ ーテックスN-30を日産化学社製スノーテックスN-40に代え、A1、Mg成分を添加せずにシリカ単独組 成にした以外は実施例1と同操作でスプレードライヤー を用い噴霧乾燥し固形物を得た。つぎに、得た固形物を ロータリーキルンで室温から300℃まで2時間かけ昇 温後1時間保持した。さらに500℃まで2時間で昇温 後1時間保持した後徐冷し、球状シリカ粒子Bを得た。 さらに水熱処理温度を80℃にし48時間水熱処理を行 い物性を測定した。X線回折から、シリカゲルと同様の 40 非晶質パターンが得られた。水銀法からは100から1 0000Åの範囲に細孔はなかった。窒素吸着法で求め た比表面積は301m²/g、細孔容積は0.22ml /g、細孔分布は、表1に示したように、細孔径30~ 50Åに91%存在する、孔径分布の狭いものであっ た。

[0029]

【比較例2】実施例2の水熱処理を行わなかった以外同 様の操作で得た焼成後の粒子の物性を測定した。X線回 折から、シリカゲルと同様の非晶質パターンが得られ

はなかった。窒素吸着法で求めた比表面積149m²/g、細孔容積0.24ml/g、細孔分布は、表1に示したように、細孔径30~50Åに15%しかなく、90Å近傍に幅の広いピークの存在するものであった。

[0030]

【実施例3】500リットルのステンレス製容器に、硝 酸アルミニウム九水和物37.6kg、硝酸5.4k g、水46.7kgを入れ撹拌しておく。ついで、シリ カゾル溶液 (日産化学社製 スノーテックスN-30 (SiO₂ 30%)) 200.0kgを少しずつ加え 混合させ、スラリーを15℃に保ち2時間撹拌する。そ の後昇温しスラリー温度が40℃になったらそのまま2 4時間保持した。このスラリーを、130℃の温度に設 定したスプレードライヤーで噴霧乾燥し固形物を得た。 つぎに、得た固形物をロータリーキルンで室温から30 0℃まで2時間かけ昇温後1時間保持した。さらに65 0℃まで2時間で昇温後1時間保持した後徐冷して、球 状シリカーアルミナ粒子Cを得た。この粒子Cを1k g、70℃に加熱された5リットルの蒸留水が入った1 0 リットルのステンレス製容器に投入しかき混ぜながら 48時間保持して水熱処理を行った。処理後水分を濾別 し空気中110℃で24時間乾燥した。試料として一部 を取り80℃の真空乾燥器で24時間乾燥後、組成分 析、比表面積、細孔分布、細孔容積の測定を行った。酸 化物としてシリカ/アルミナ/=92.1/7.9であ った。X線回折からはシリカゲルと同様の非晶質パター ンが得られた。水銀法細孔分布測定からは100から1 0000Åの範囲に細孔はなかった。窒素吸着法で求め た比表面積は211m²/g、細孔容積は0.25ml /gであった。細孔分布は、表1に示したように、細孔 30 径30~50Åに89%存在する狭い細孔分布を示し

た。

[0031]

【実施例4】 500リットルのステンレス製容器に、チ タニアゾル (石原テクノ社製 STS-018 (TiO 2 30%)) 12.8kgを入れ撹拌しておく。つい で、シリカゾル溶液(日産化学社製 スノーテックスN -30 (SiO₂ 30%)) 200. 0kgを少しず つ加え混合させ、スラリーを15℃に保ちそのまま24 時間保持した。このスラリーを、130℃の温度に設定 したスプレードライヤーで噴霧乾燥し固形物を得た。つ ぎに、得た固形物をロータリーキルンで室温から300 ℃まで2時間かけ昇温後1時間保持した。さらに550 ℃まで2時間で昇温後1時間保持した後徐冷して、球状 シリカーチタニア粒子Dを得た。この粒子Dを1kg、 90℃に加熱された5リットルの蒸留水が入った10リ ットルのステンレス製容器に投入しかき混ぜながら12 時間保持して水熱処理を行った。処理後水分を濾別し空 気中110℃で24時間乾燥した。試料として一部を取 り80℃の真空乾燥器で24時間乾燥後、組成分析、比 表面積、細孔分布、細孔容積の測定を行った。酸化物と してシリカ/チタニア=93.9/6.0であった。X線回折からは主なピークはシリカゲルと同様の非晶質パ ターンであった。水銀法細孔分布測定からは100から 10000Åの範囲に細孔はなかった。窒素吸着法で求 めた比表面積は236m²/g、細孔容積は0.26m 1/gであった。細孔分布は、表1に示したように、細 孔径30~50Åに88%存在する狭い細孔分布を示し

[0032]

) 【表1】

	実施例1		比較例1		実施例2		比较例2		実施例3		実施例4	
網孔半径												
(A)	cc/g	存在率%	oc/g	存在率%	oc/g	存在率等	CC/E	存在率领	_cc/g	存在率域	cc/g	存在率》
10~12.5	0.00218	0.84	0.00852	3.04	0.00855	3.88	0.00852	3.52	0.00978	3.91	0.00955	3.66
12. 5~15	0.00117	0.45	0.00789	2.82	0.00927	4.19	0.00789	3.26	0.00926	3.71	0.01031	3.95
15~17. 5	0.00140	0.54	0.00837	2.99	0.01933	8.74	0.00837	3.46	0.01183	4.74	0.01400	5.36
17. 5~20	0.00635	2.45	0.00754	2.69	0.07229	32.68	0.01135	4.69	0.04153	16.64	0.03235	12,39
20~22. 5	0.23770	91.60	0.01342	4.79	0.10684	48.30	0.00753	3.11	0.16439	65.86	0.18107	69.37
22, 5~25	0.00113	0.43	0.00965	3.44	0.00283	1.28	0.00965	3.99	0.00420	1.68	0.00113	0.43
25~27.5	0.00159	0.61	0.01146	4.09	0.00038	0.17	0.00905	3.74	0.00100	0.40	0.00159	Q.81
27. 5~30	0.00142	0.55	0.01327	4.74	0.00026	0.12	0.01082	4.47	0.00082	0.33	0.00142	0.54
30~32.5	0.00000	0.00	0.01675	5.98		0.07	0.01085	4.48		0.36	0.00000	0.00
32. 5~35	0.00094	0.36	0.03160	11.28	0.00015	0.07	0.01133	4.69	0.00097	0.39	0.00094	0.36
35~37.5	0.00026	0.10	0.04812	17.17	0.00000	0.00		5.11	0.00000	0.00	0.00026	0.10
37. 5~40	0.00000	0.00	0.03847	13.01	0.00021	0.09	0.01351	5.58	0.00000	0.00	0.00000	0.00
40~42. 5	88000.0	0.34	0.02313	8.25	0.00000	0.00	0.01513	5.25	0.00093	0.37	0.00088	0.34
42. 5~45	0.00000	0.00	0.01334	4.76		0.05		10.87	0.00000	0.00	0.00000	0.00
45~47. 5	0.00000	0.00	0.01283	4.58	0.00000	0.00		15.16	0.00000	0.00	0.00000	0.00
47. 5~50	0.00098	0.38	0.00947	3.38	0.00000	0.00	0.01367	5.65	0.00124	0.50	0.00098	0.38
50~52. 5	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00
52. 5~55	0.00000	0.00	0.00166	0.59		0.14	0.00617	2.55	0.00000	0.00	0.00000	0.00
55~57, 5	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00		0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00
57. 5~60	00000£0	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00102	0.41	0.00000	0.00
60~62. 5	0.00233	0.90	0.00147	0.52	0.00000	0.00	0.00947	3.91	0.00000	0.00	0.00073	0.28
65~67. 5	000000.0	0.00	0.00000	0.00	0.00031	0.14	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00
67. 5~70	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00
77, 5~80	000000.0	0.00	0.00319	1.14	0.00000	0.00	0.00819	3.39	0.00000	0.00	0.00000	0.00
80~82. 5	000000.0	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00097	0.39	0.00000	0.00
82. 5~85	0.00066	0.25	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00086	0.25
90~92.5	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00022	0.10	0,00000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00
92. 5~95	000000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00		0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00
117. 5~120	0.00000	0.00	0.00207	0.74		0.00	3	2.10	0.00000	0.00	0.00000	0.00
135~137. 5	0.00052	0.20	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	0.00078	0.31	0.00518	1.98

[0033]

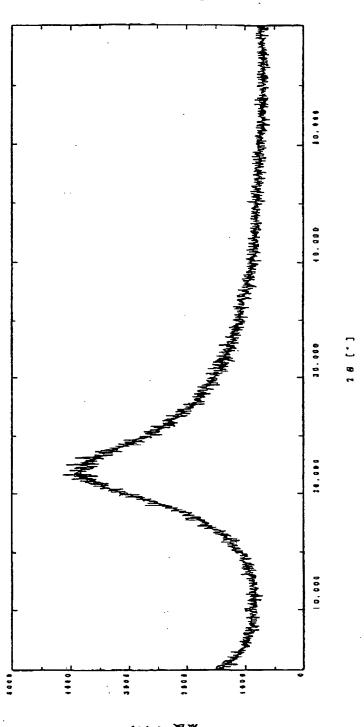
【発明の効果】本発明のシリカ系非晶質材料は、細孔直径が30~50Åの範囲に細孔容積の80%以上がある、極めてシャープな細孔分布構造を有するシリカ系非晶質材料であり、細孔容積が小さく緻密であることから機械的強度が強く、かつ比表面積が大きいことから、顔料、充填剤、研磨剤、化粧品基剤、農業用担体、触媒、触媒担体、吸着剤、機能膜材料等の機能材料として、産

業上大いに有用である。また、本発明のシリカ系非晶質 材料は、シリカ系材料からなるスラリーを調製、乾燥、 焼成後、簡単な水熱処理操作によって再現性良く製造す ることできるという効果もある。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1で得られたシリカ系非晶質材料のX線 回折スペクトル図である。





フロントページの続き

F ターム(参考) 4G072 AA03 BB05 BB13 BB15 JJ26 RR19 TT05 TT08 TT09 UU07 UU11 UU15 UU17